

NUMERO ISSUE

IN FOCUS FOCUS ON

Dossier: Punto della situazione sugli argomenti più attuali (Feature article)
Mercati: Analisi di mercato supportata da Istituti di Ricerca (Markets analysis provided by most dependable sources of information)
Vetrina: Novità di prodotto relative a un argomento specifico (Latest products regarding a specific topic)
Tecnologia: Analisi delle tecnologie e degli scenari in atto nei settori trainanti (Tech insight)

ATTUALITÀ TOPICS

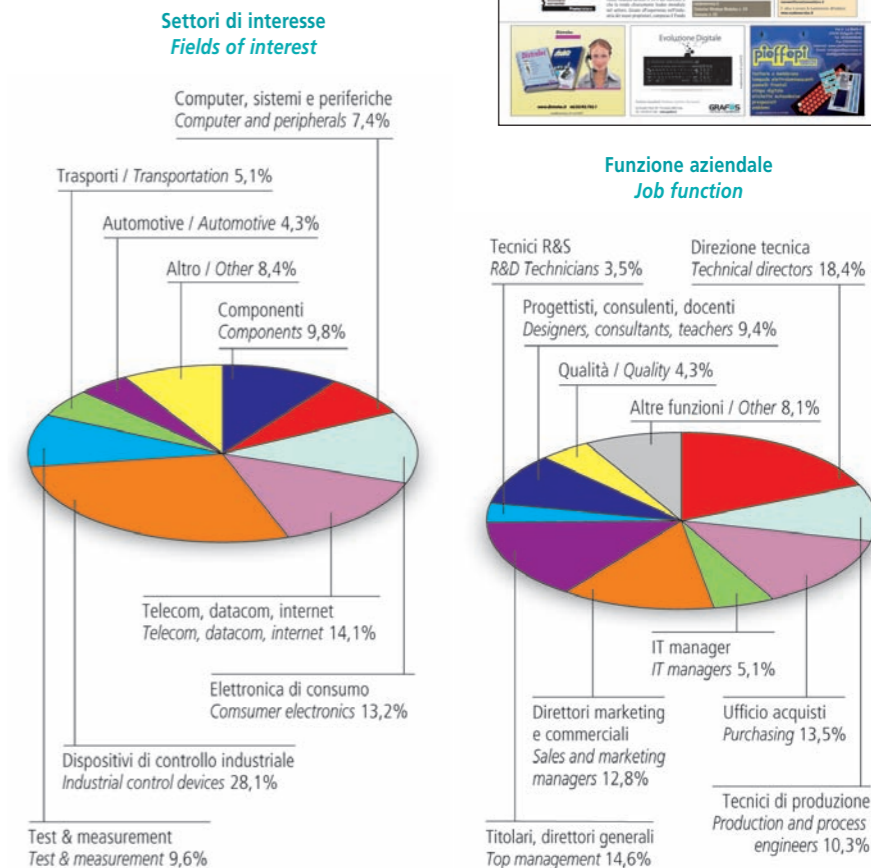
Articoli dedicati a temi di particolare interesse (The latest on specific topics)
Distribuzione: Sezione dedicata al mondo della distribuzione. Si approfondiscono i temi di maggiore attualità (Section covering distribution strategies)
Interviste: Contatto diretto con le aziende (Interview: direct contact with the companies)
La parola alle aziende: Contributi dalle aziende (Companies' contributed articles)
Tavole Rotonde: Incontro con le aziende (Round Table)

506 Gennaio January	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Memorie non volatili (NV memories) Dossier: Nanotecnologie (Nanotechnologies) Vetrina: Microcontrollori (Microcontrollers) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Display (Displays) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
507 1° Febbraio February	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Componenti embedded (Embedded components) Tecnologia: LTE - 4G (LTE - 4G) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) La parola alle aziende (Companies' contributed articles) Tavola Rotonda: Distribuzione (Distribution)
508 2° Febbraio February	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Dispositivi wireless (Wireless devices) Dossier: Mems (MEMS) Vetrina: Connettori (Connectors) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Sistemi operativi real time (RTOS) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
509 1° Marzo March	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: IC analogici (Analog ICs) Dossier: Software Open Source (Open source software) Tecnologia: Ottica e Fotonica (Optics and photonics) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Strumentazione portatile (Portable instruments) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
510 2° Marzo March	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: IC digitali (Digital ICs) Tecnologia: Localizzazione satellitare (Localisation by satellite) Vetrina: Multimetri (Multimeters) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Amplificatori operazionali (Op Amps) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
511 1° Aprile April	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Logiche programmabili (Programmable logics) Dossier: Energie rinnovabili (Renewable sources) Tecnologia: Radiodiffusione digitale - DRM - digital radio mondiale (DRM, Digital Radio Mondial) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) La parola alle aziende (Companies' contributed articles) Tavola Rotonda: Strumentazione (T&M)
512 2° Aprile April	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Microprocessori (Microprocessors) Dossier: Domotica o home automation (Home automation) Tecnologia: Bus seriali per auto (Automotive serial buses) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Strumentazione modulare (Modular instrumentation) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
513 1° Maggio May	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Mems (MEMS) Tecnologia: Fotovoltaico (Photovoltaics) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Sistemi di sviluppo (Development tools) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
514 2° Maggio May	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: SOC system on chip (SOC) Dossier: Tecnologie per la telematica, la navigazione satellitare e il posizionamento indoor (Telematics, navigation by satellite and indoor localisation) Tecnologia: Memorie non volatili (NV memories) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) La parola alle aziende (Companies' contributed articles) Tavola Rotonda: Wireless (Wireless)
515 1° Giugno June	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Power IC (Power ICs) Dossier: Produzione/CEM - contract electronic manufacturer (Contract Manufacturing) Tecnologia: Wimedia/Wireless USB (Wubusb) (Wimedia, Wireless USB) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Nanotecnologie (Nanotechnologies) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
516 2° Giugno June	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Asic (ASIC) Dossier: Elettrodomestici (Home appliances) Tecnologia: Batterie e caricabatterie (Batteries and chargers) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Aerospaziale (Aerospace and defence) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
517 Luglio/Agosto July/August	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Passivi (Passive components) Dossier: Biomedicale (Medical devices) Tecnologia: Transistor (Transistors) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Microprocessori (Microprocessors) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
518 1° Settembre September	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: T&M (T&M) Vetrina: Software EDA - Electronic Design Automation (EDA) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) La parola alle aziende (Companies' contributed articles) Tavola Rotonda: PC industriali (Industrial PCs)
519 2° Settembre September	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: EDA (EDA) Dossier: Comunicazioni wireless (Wireless comms) Vetrina: ATE (ATE) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Power management (Power Management) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
520 1° Ottobre October	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: WiMax (WiMax) Dossier: Sicurezza (Security) Tecnologia: Relè allo stato solido (Solid state relays) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Memorie innovative (Innovative memories) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
521 2° Ottobre October	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Componenti discreti (transistor, diodi... (Discrete components: transistors, diodes, ...)) Tecnologia: Led ad alta efficienza (High efficiency LEDs) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) La parola alle aziende (Companies' contributed articles) Tavola Rotonda: Applicazioni embedded (Embedded applications)
522 1° Novembre November	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: DSP (DSP) Dossier: Elettronica su rotaia (Electronics for railways) Tecnologia: Sistemi di saldatura (Soldering) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Sensori (Sensors) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
523 2° Novembre November	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: M2M (M2M) Dossier: Broadcasting (Broadcasting) Tecnologia: Boundary scan 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) Intervista: Banda larga (Broadband technologies) La parola alle aziende (Companies' contributed articles)
524 Dicembre December	<ul style="list-style-type: none"> Mercati: Optoelettronica (Optoelectronics) Dossier: Elettronica per la difesa (Defence electronics) Vetrina: Arredi e attrezzature da laboratorio (banchi di lavoro) (Workbenches and repair tools) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione: L'opinione (Distribution: Point of View) La parola alle aziende (Companies' contributed articles) Tavola Rotonda: Elettronica di potenza (Power electronics)

FIERE EXHIBITIONS

- Real Time and Embedded Computing Conference, febbraio - Atlanta (GA-USA) / Huntsville (AL-USA) / Melbourne (FL-USA)
ICQNM 2009 - The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, 01-06/02, Cancun (MEX)
- MC-Motion Control for, febbraio, (I)
NI Days, febbraio, Milano
- Real Time and Embedded Computing Conference, marzo, Dallas, Huston (TX-USA)
Embedded World, 03-05/03, Norimberga (D)
Smart Systems Integration, 10-11/03, Bruxelles (B)
EMV, 10-12/03, Stoccarda (D)
PCIM China, 17-19/03, Shanghai (PRC)
- Embedded Systems Conference - Silicon Valley, 14-18/04, San Jose (CA-USA)
Display, 15-17/04, Tokyo (J)
Hannover Messe, 20-24/04, Hannover (D)
DATE, 20-24/04, Nizza (F)
- SMT Hybrid Packaging, 05-07/05, Norimberga (D)
PCIM Europe, 12-14/05, Norimberga (D)
- Laser World of Photonics, 15-18/06, Monaco (D)
European Automotive Components Expo 16-18/06, Stoccarda (D)
- VforM-Vision for Manufacturing, giugno, (I)
- NI Week, agosto, Austin (TX-USA)
- Embedded System Conference, settembre, Boston (MA-USA)
NanoForum, settembre, Milano (I)
- C²-Control & Communication, settembre, (I)
- Microelettronica, 01-03/10, Vicenza (I)
Semicon Europe, 06-08/10, Stoccarda (D)
SAME, 07-08/10, Sophia Antipolis (F)
- Productronica, 10-13/11, Monaco (D)
SPS/IPC/Driver, 24-26/11, Norimberga (D)
- Focus Embedded, novembre, (I)

CHI LEGGE EO NEWS READERS OF EO NEWS



Formati	Formats	Euro 4/c	Euro b/n b/w
Manchette	Manchette	1.233,00	1.233,00
Spazio mercato	Spazio mercato	353,00	353,00
1/4 pagina	1/4 page	970,00	764,00
1/3 pagina	1/3 page	1.086,00	969,00
1/2 pagina uni	1/2 page	1.821,00	1.233,00
2/3 pagina	2/3 page	1.996,00	1.586,00
Junior	Junior	1.880,00	1.629,00
Pagina	Page	2.525,00	1.937,00
King size	King size	3.171,00	2.231,00
1/2 king size	1/2 king size	2.231,00	1.645,00
Doppia king size	Double king size	6.340,00	4.462,00
I romana	Third page	2.932,00	2.229,00
Piedino I romana	Foot at third page	2.258,00	2.258,00
Doppia mezza	Double half page	3.640,00	2.467,00
Doppia pagina	Double page	5.049,00	3.875,00
Cartolina	Post card	1.800,00	1.800,00
Sovrapertina	Over leaf		
132 x 235 mm	132 x 235 mm	2.965,00	2.965,00
Inserto 2 facciate	Insert 2 front	2.500,00	2.500,00
Inserto 4 facciate	Insert 4 front	4.100,00	4.100,00
Supplemento colore	Colour supplement	+20%	+20%
Posizioni speciali	Special position	+15%	+15%

Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita
Space booking: 45 days before publication date

Consegna materiale: 35 gg prima della data di uscita
Delivery material: 35 days before publication date

Periodicità Frequency

Quindicinale 19 numeri
Fortnightly 19 issues

Data pubblicazione Issue date

1° e 3° settimana del mese
1st and 3rd week of each month

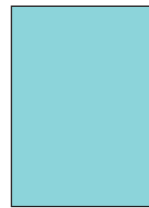
Tipo di stampa Printing process

Offset piena
Web offset

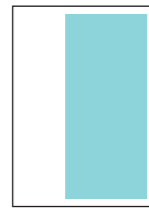
FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE OGGI
FIELD BUS & NETWORKS
ELETTRONICA OGGI
ELETTRONICA OGGI EMBEDDED
RMO - Rivista di Meccanica Oggi

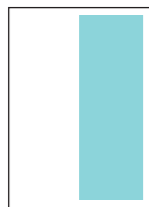
SdA - Soluzioni di Assemblaggio
PROGETTARE
FLUIDOTECNICA
INQUINAMENTO
RICH-MAC CHIMICA NEWS
ENERGIE OGGI



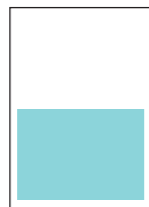
PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
190 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



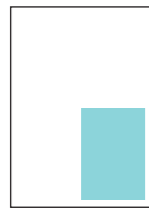
2/3 PAG. VERTICALE
IN GABBIA
2/3 PAGE VERTICAL
(TYPE AREA)
118 X 260 mm



1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
100 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



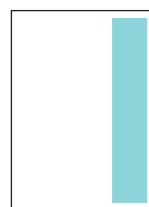
1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
210 X 140 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
190 X 130 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/4 PAG. ORIZZONTALE
1/4 PAGE HORIZONTAL
100 X 130 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 120 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



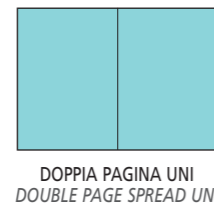
1/3 PAG. ORIZZONTALE
1/3 PAGE HORIZONTAL
210 X 105 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
181 X 90 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/3 PAG. VERTICALE
1/3 PAGE VERTICAL
80 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
56 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



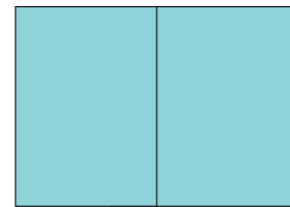
PAGINA INTERA
FULL PAGE
148 X 210
(VIVO + REFILI) / BLEED
125 X 190
(IN GABBIA) / TYPE AREA



DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
296 X 210
(VIVO + REFILI) / BLEED
270 X 190
(IN GABBIA) / TYPE AREA

FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

EO NEWS



DOPPIA KING SIZE
DOUBLE KING SIZE PAGE
530 X 310 mm + REFILI / BLEED
500 X 290 mm IN GABBIA / TYPE AREA



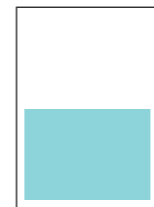
KING SIZE / KING SIZE
265 X 310 mm
+ REFILI / BLEED
245 X 290 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



UNI / UNI PAGE
203 X 230 mm
+ REFILI / BLEED
187 X 218 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



1/2 PAGINA VERTICALE
1/2 PAGE VERTICAL
132 X 310 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 262 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



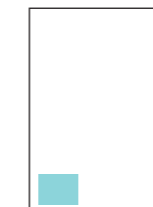
1/2 PAGINA ORIZZONTALE
1/2 PAGE HORIZONTAL
265 X 154 mm
+ REFILI / BLEED
235 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



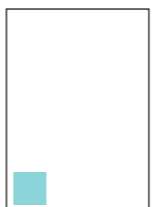
1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE
133 X 155 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



JUNIOR / JUNIOR
154 X 201 mm
+ REFILI / BLEED
140 X 183 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



MANCHETTE 1° COPERTINA
79 X 61 mm
MANCHETTE NEWS
91 X 61 mm

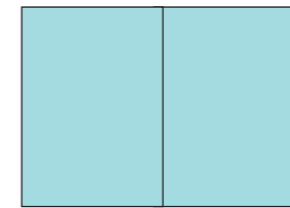


SPAZIO MERCATO
78 X 78 mm

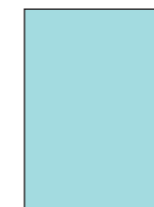
DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA
PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA
1/3 DI PAGINA: 67 X 262 SOLO IN GABBIA

FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE



DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
420 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
90 X 240 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
180 X 125 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

- IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 140 X 180 mm
SENZA REFILI
- FIRST COVER (IMAGE) 140 X 180 mm
BLEED

SPECIFICHE TECNICHE PER IL MATERIALE DI STAMPA

Formati: formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi) ottimizzato per la stampa, più 3 mm per lato di refilo.

Supporti: CD, Server Sharepoint di Fiera Milano Editore
N.B: non inviare i file per posta elettronica.

Le lavorazioni di materiali non conformi alle specifiche sopra citate sia tecniche che di formato saranno fatturate forfettariamente (€ 50,00).

DETAILS FOR PRINTING MATERIAL

Formats: PDF format in highest resolution (300 dpi) ready for printing, with 3 mm of space at perimeter.

Supports: CD, Sharepoint Server of Fiera Milano Editore
N.B: do not send any file by e-mail.

Any modification of materials not conforming to the a.m. technical and size details will be invoiced at a forfait cost (€ 50,00).

Giuseppe De Gasperis

Sales Manager - Divisione Technology

Edizioni Fiera Milano SpA Divisione Technology

Viale Espinasse, 141

20156 Milano

Tel. +39 02 36 60 92 523

Fax +39 02 36 60 92 524

Mobile +39 34 87 14 67 48

E-mail: giuseppe.degasperis@fieramilanoeditore.it

Siti web: www.ilb2b.it - www.fieramilanoeditore.it

WORLDWIDE ADVERTISING sales offices

U.K. - SCANDINAVIA - NETHERLAND AND BELGIUM:

The Huson European Media - Gerry Rhoades-Brown

tel.: +44 1932 564999 - fax: +44 1932 564998

SWITZERLAND: Agentur Iff - Bernard Kull

tel.: +41 52 6330888 - fax: +41 52 6330899

GERMANY AND AUSTRIA: Media Agentur - Adela Ploner

tel.: +49 8131 3669920 - fax: +49 8131 3669929

USA: The Huson International Media USA - Ralph S. Lockwood

tel.: +1 408 8796666 - fax: +1 408 8796669

TAIWAN: Worldwide Services co. Ltd, Mr Robert Yu

tel.: +886-4-23251784 - fax: +886-4-23252967